

FFC용 열가소형 전자파 Shield Film

SF-FC700



SF-FC700은 Heat Seal형 (열가소형) 의 전자파 Shield Film입니다. 박막형성 기술에 의해 불과 30 μ m의 Film두께를 실현하였습니다. 초경량으로 굴곡성이 우수하기 때문에 휴대기기 등 각종선재의 Shield에 적합합니다.

특징

▶ 초경량, 고굴곡

Film의 두께가 29 μ m로 얇고, 초경량, 고굴곡

▶ 저온, 단시간접착

Heat Seal형 도전성 접착제에 의해, 각종기재와의 접착이 용이

▶ 우수한 Shield 효과

표면저항 200m Ω /□의 금속박막층에 의해, 우수한 Shield특성을 실현

▶ 자유도 높은 Film폭

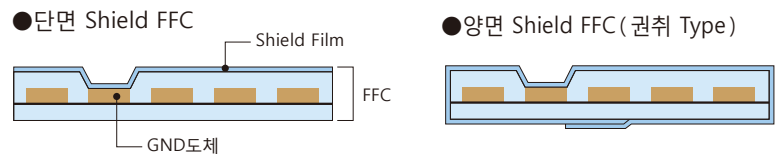
Film폭 16mm~570mm의 범위에서 용도에 맞는 선택이 가능

▶ 소량 Lot대응

필요에 의한 양만큼 생산이 가능

제품사양

항 목	사 양		
이형 Film	재질	OPP	
	두께	40 μ m	
도전성접착제	수지	플라에스테르계 (열가소형)	
	Filler	Ag Coat Cu분말	
	두께	20 μ m	
	접착강도	4N/cm (对PET)	
		온도	120 $^{\circ}$ C
압력			0.5~1.0MPa
시간	5~10sec		
금속박막	재질	은	
	두께	800 \AA (약0.1 μ m)	
	표면저항	200m Ω /□	
Base Film	재질	PET	
	두께	9 μ m	



SF-FC700 구성

